



คู่มืออ้างอิงเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์

ไคลเอ็นต์แบบบางของ HP

## ข้อมูลลิขสิทธิ์

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง: กรกฎาคม 2017

หมายเลขภาคผนวกของเอกสาร: 933573-281




## การรับประกัน

ข้อมูลที่ระบุไว้ในที่นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การรับประกันของผลิตภัณฑ์และบริการของ HP จะปรากฏอยู่ในประกาศการรับประกันอย่างชัดเจนที่จัดส่งให้พร้อมกับผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าวเท่านั้น ข้อความในที่นี้จะไม่ผลเป็นการรับประกันเพิ่มเติมใดๆ ทั้งสิ้น HP จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดหรือการขาดหายของข้อมูลด้านเทคนิคหรือเนื้อหาของเอกสารนี้

การรับประกันของผลิตภัณฑ์และบริการของ HP จะปรากฏอยู่ในประกาศการรับประกันอย่างชัดเจนที่จัดส่งให้พร้อมกับผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าวเท่านั้น ข้อความในที่นี้จะไม่ผลเป็นการรับประกันเพิ่มเติมใดๆ ทั้งสิ้น HP จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดหรือการขาดหายของข้อมูลด้านเทคนิคหรือเนื้อหาของเอกสารนี้

## เกี่ยวกับคู่มือนี้

---

-  **คำเตือน!** ข้อความที่เริ่มต้นด้วยสัญลักษณ์ลักษณะนี้ แสดงถึงโอกาสอันอาจเกิดอันตรายต่อร่างกายหรือชีวิตของผู้ใช้หากมิได้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด
  -  **ข้อควรระวัง:** ข้อความที่เริ่มต้นด้วยสัญลักษณ์ลักษณะนี้ แสดงถึงโอกาสอันอาจเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์หรือการสูญหายของข้อมูล หากมิได้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด
  -  **หมายเหตุ:** ข้อความที่เริ่มต้นด้วยสัญลักษณ์ลักษณะนี้หมายถึงข้อมูลเพิ่มเติมที่สำคัญ
-



# สารบัญ

<b>1 คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ .....</b>	<b>1</b>
ส่วนประกอบที่แผงด้านหน้า .....	1
ส่วนประกอบที่แผงด้านหลัง .....	2
ตำแหน่งของหมายเลขผลิตภัณฑ์ .....	2
<b>2 ตั้งค่า .....</b>	<b>3</b>
คำเตือนและข้อควรระวัง .....	3
การติดตั้งหน่วยวาง .....	3
การเชื่อมต่อสายไฟ AC .....	4
การปกป้องตัวเครื่องไคลเอ็นต์แบบบาง .....	5
การติดตั้งตัวและการจัดวางตัวเครื่องไคลเอ็นต์แบบบาง .....	6
HP Quick Release .....	6
รูปแบบการติดตั้งที่รองรับ .....	8
รูปแบบและลักษณะการจัดวางที่รองรับ .....	10
รูปแบบการจัดวางที่ไม่รองรับ .....	11
การดูแลรักษาตามปกติสำหรับไคลเอ็นต์แบบบาง .....	11
<b>3 การคายประจุไฟฟ้าสถิต .....</b>	<b>12</b>
การป้องกันความเสียหายจากการคายประจุไฟฟ้าสถิต .....	12
วิธีการต่อสายดิน .....	12
<b>4 ข้อมูลการขนย้าย .....</b>	<b>13</b>
การเตรียมการขนย้าย .....	13
ข้อมูลบริการซ่อมแซมที่สำคัญ .....	13
<b>5 คุณสมบัติสำหรับผู้ทุพพลภาพ .....</b>	<b>14</b>
เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกที่รองรับ .....	14
การติดต่อฝ่ายสนับสนุน .....	14
<b>ดัชนี .....</b>	<b>15</b>



# 1 คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

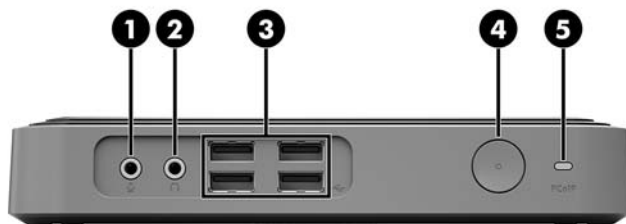


คู่มือนี้อธิบายเกี่ยวกับคุณลักษณะของโคลเอ็นต์แบบบาง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้บนนี้ โคลเอ็นต์แบบบาง สามารถดูได้จาก <http://www.hp.com/go/quickspecs> แล้วค้นหาโคลเอ็นต์แบบบางรุ่นนี้

ทั้งนี้ โคลเอ็นต์แบบบางมีตัวเลือกให้เลือกหลายรูปแบบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกต่างๆ ที่มี โปรดดูจากเว็บไซต์ HP ที่ <http://www.hp.com> แล้วค้นหาโคลเอ็นต์แบบบางที่คุณต้องการ

## ส่วนประกอบที่แผงด้านหน้า

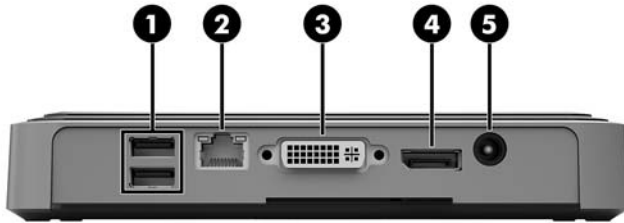
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดูได้จาก <http://www.hp.com/go/quickspecs> แล้วค้นหาโคลเอ็นต์แบบบางรุ่นที่ต้องการเพื่อเรียกดู QuickSpecs (ข้อมูลจำเพาะโดยย่อ)



รายการ	ส่วนประกอบ	รายการ	ส่วนประกอบ
1	แจ็คไมโครโฟน	4	ปุ่มเปิด/ปิด
2	แจ็คหูฟัง	5	พอร์ต PC over IP (PCoIP)
3	พอร์ต USB (4)		

## ส่วนประกอบที่แผงด้านหลัง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดูได้จาก <http://www.hp.com/go/quickspecs/> แล้วค้นหาไคลเอ็นต์แบบบางรุ่นที่ต้องการเพื่อเรียกดู QuickSpecs (ข้อมูลจำเพาะโดยย่อ)



รายการ	ส่วนประกอบ	รายการ	ส่วนประกอบ
1	พอร์ต USB (2)	4	พอร์ต DisplayPort
2	พอร์ต Small Form Pluggable (SFP) สำหรับรับส่งสัญญาณไฟเบอร์	5	หัวต่อสายไฟ
3	พอร์ต DVI-D		

## ตำแหน่งของหมายเลขผลิตภัณฑ์

ไคลเอ็นต์แบบบางทุกเครื่องจะมีหมายเลขลำดับผลิตภัณฑ์ติดเอาไว้ตั้งแสดงในภาพประกอบต่อไปนี้ กรุณาเตรียมหมายเลขนี้ให้พร้อมเมื่อติดต่อเข้ามายังฝ่ายบริการเพื่อขอรับความช่วยเหลือ





## 2 ตั้งค่า

### คำเตือนและข้อควรระวัง

ก่อนที่จะลงมืออัปเดตอุปกรณ์ โปรดอ่านคำแนะนำ ข้อควรระวัง และคำเตือนในคู่มือนี้อย่างละเอียด

**⚠ คำเตือน!** เพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากไฟฟ้าลัดวงจร ผิวสัมผัสที่ร้อน หรือเพลิงไหม้:

ถอดสายไฟ AC ออกจากเต้าเสียบ AC แล้วปล่อยให้ชิ้นส่วนภายในของระบบเย็นลงก่อนสัมผัส

อย่าเสียบขั้วต่อของสายโทรศัพท์หรือสายโทรคมนาคมอื่นใดเข้ากับพอร์ต SFP สำหรับรับส่งสัญญาณไฟเบอร์

อย่าเลี่ยงการใช้สายไฟ AC แบบมีสายดิน ปลั๊กสำหรับการต่อสายดินเป็นคุณลักษณะด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

เสียบสายไฟ AC เข้ากับเต้าเสียบ AC ที่มีการต่อลงกราวด์ (สายดิน) ซึ่งสะดวกต่อการใช้งานตลอดเวลา

เพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บรุนแรง โปรดอ่าน *คู่มือเพื่อความสะดวกและความปลอดภัย* คู่มือดังกล่าวจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องเวิร์กสเตชันอย่างเหมาะสม รวมถึงทำนั้ง พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการทำงานสำหรับผู้ใช้เครื่องไคลเอ็นต์แบบบาง และให้ข้อมูลความปลอดภัยด้านไฟฟ้าและกลไกที่สำคัญ ทั้งนี้ *คู่มือเพื่อความสะดวกและความปลอดภัย* สามารถเรียกดูได้จากเว็บไซต์ของ HP ที่ <http://www.hp.com/ergo>

**⚠ คำเตือน!** มีชิ้นส่วนที่มีกำลังไฟฟ้าอยู่ใน

ถอดสายไฟอุปกรณ์ก่อนที่จะถอดฝาครอบเครื่อง

เปลี่ยนและติดตั้งโครงเครื่องให้แน่นหนาก่อนที่จะเสียบปลั๊กไฟของอุปกรณ์อีกครั้ง

**⚠ ข้อควรระวัง:** ไฟฟ้าสถิตอาจทำให้ส่วนประกอบทางไฟฟ้าของไคลเอ็นต์แบบบางหรืออุปกรณ์เสริมเกิดการชำรุดเสียหายได้ ก่อนที่จะเริ่มต้นกระบวนการเหล่านี้ โปรดตรวจสอบว่าคุณได้คายประจุไฟฟ้าสถิตด้วยการสัมผัสวัตถุที่เป็นโลหะและมีการลงกราวด์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ **การป้องกันความเสียหายจากการคายประจุไฟฟ้าสถิตในหน้า 12**

เมื่อเสียบปลั๊กไคลเอ็นต์แบบบางเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ AC จะมีแรงดันไฟฟ้าส่งไปยังเมนบอร์ดอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสียหายต่อส่วนประกอบภายใน คุณต้องถอดสายไฟ AC ออกจากจากแหล่งจ่ายไฟก่อนที่จะเปิดเครื่องไคลเอ็นต์แบบบางดังกล่าว

### การติดตั้งแท่นวาง

**⚠ ข้อควรระวัง:** หากต้องการใช้เครื่องไคลเอ็นต์แบบบางในลักษณะวางตั้ง ควรใช้งานร่วมกับแท่นวางเพื่อความมั่นคงและเพื่อให้เกิดการถ่ายเทอากาศโดยรอบตัวเครื่องอย่างเหมาะสม

คุณสามารถจัดวางเครื่องไคลเอ็นต์แบบบางในลักษณะวางตั้งขึ้นได้ โดยใช้แท่นวางที่มาพร้อมกับตัวเครื่อง

1. ถอด/คลายอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่กันไม่ให้มีการเปิดตัวเครื่องไคลเอ็นต์แบบบาง
2. ถอดสล็อตที่กั้นแบบถอดได้ออกจากไคลเอ็นต์แบบบาง เช่น แฟลชไดรฟ์ USB
3. ปิดไคลเอ็นต์แบบบางให้เรียบร้อยผ่านระบบปฏิบัติการ จากนั้นเปิดอุปกรณ์ภายนอกใดๆ ทั้งหมด
4. ถอดสายไฟ AC ออกจากเต้าเสียบ AC และถอดอุปกรณ์ภายนอกใดๆ ออกทั้งหมด
5. ติดแท่นวางเข้ากับไคลเอ็นต์แบบบาง
  - a. พลิกเครื่องไคลเอ็นต์แบบบางคว่ำลง และมองหารูของสกรูและรอยเว้าบริเวณด้านล่างของตัวเครื่อง

- b. จัดตำแหน่งแผ่นวางเข้ากับด้านล่างของตัวเครื่อง โดยให้ส่วนนูนและรูของสกรูบนแผ่นวางอยู่ในตำแหน่งเดียวกับบนโคลเอ็นด์แบบบาง




- c. สอดและขันสกรูที่นำมาให้แนบ

6. ต่อสายไฟ AC กลับคืน และเปิดเครื่องโคลเอ็นด์แบบบาง

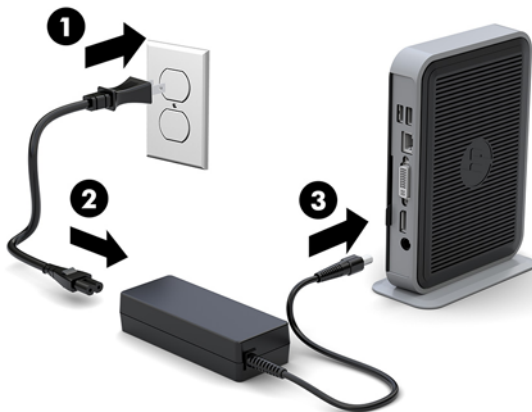
 **หมายเหตุ:** ตรวจสอบว่ามีพื้นที่ว่างรอบข้างตัวเครื่องในทุกด้านอย่างน้อย 10.2 เซนติเมตร (4 นิ้ว) และไม่มีสิ่งใดกีดขวางโดยรอบ

7. ล็อกอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่ถูกลดออกในตอนถอดฝาครอบหรือถอดแผงปิดเครื่องให้กลับเข้าที่

 **หมายเหตุ:** ฉากยึดการติดตั้ง Quick Release (อุปกรณ์เสริม) สามารถหาซื้อได้จาก HP เพื่อใช้ในการติดตั้งโคลเอ็นด์แบบบางเข้ากับบนผนัง โต๊ะ และสวิงอาร์ม หากมีการใช้ฉากยึดการติดตั้ง กรุณาอย่าติดตั้งตัวเครื่องโดยที่พอร์ต I/O อยู่ในตำแหน่งหันลงพื้น

## การเชื่อมต่อสายไฟ AC

1. เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบ AC (1) และต่อปลายอีกด้านเข้ากับอะแดปเตอร์ไฟฟ้า (2)
2. ต่ออะแดปเตอร์ไฟฟ้าเข้ากับขั้วต่อแหล่งจ่ายไฟที่ด้านหลังของโคลเอ็นด์แบบบาง (3)

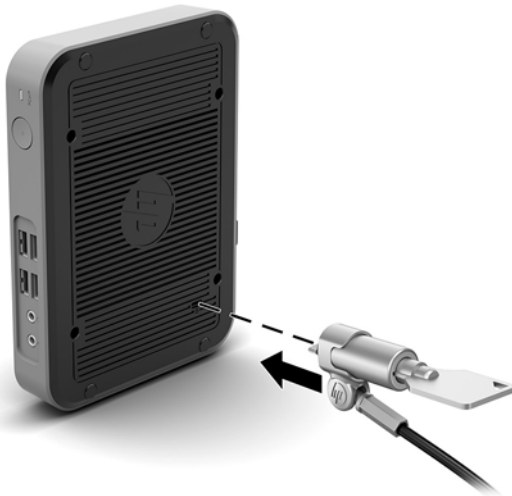


## การปกป้องตัวเครื่องไคลเอ็นต์แบบบาง

ไคลเอ็นต์แบบบางถูกออกแบบมาให้ใช้งานร่วมกับสายล็อกได้ โดยสายล็อกช่วยป้องกันการถอดเครื่องไคลเอ็นต์แบบบางโดยไม่ได้รับอนุญาต ตลอดจนเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการเข้าถึงชิ้นส่วนที่สำคัญ หากต้องการสั่งซื้ออุปกรณ์ชิ้นนี้ กรุณาไปยังเว็บไซต์ของ HP ที่ <http://www.hp.com> และค้นหารุ่นของไคลเอ็นต์แบบบางที่คุณใช้งาน

ไคลเอ็นต์แบบบางมีช่องเสียบสายล็อกอยู่สองจุด: จุดหนึ่งอยู่บริเวณด้านล่าง และอีกจุดหนึ่งอยู่บริเวณด้านข้าง หากมีการติดตั้งแทนวางให้ใช้ช่องเสียบบริเวณด้านข้าง หากไม่มีการติดตั้งแทนวาง และใช้ ไคลเอ็นต์แบบบางในลักษณะวางนอน ให้ใช้ช่องเสียบบริเวณด้านล่าง

1. เลือกช่องเสียบสายล็อกหนึ่งจุดที่ต้องการ
2. ใส่สายล็อกเข้าไปในช่องดังกล่าว แล้วใช้กุญแจเพื่อปิดล็อก



**หมายเหตุ:** สายล็อกได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องคอมพิวเตอร์ แต่อาจไม่สามารถป้องกันการโจรกรรมหรือการใช้งานไคลเอ็นต์แบบบางในทางที่ผิด

# การติดตั้งและการจัดวางตัวเครื่องไคลเอ็นต์แบบบาง

## HP Quick Release

ฉากยึดการติดตั้ง Quick Release (อุปกรณ์เสริม) สามารถหาซื้อได้จาก HP เพื่อใช้ในการติดตั้งไคลเอ็นต์แบบบางเข้ากับผนัง โต๊ะ และสวิงอาร์ม หากมีการใช้ฉากยึดการติดตั้ง กรุณาย้ายติดตั้งตัวเครื่องโดยที่พอร์ต I/O อยู่ในตำแหน่งหันลงพื้น

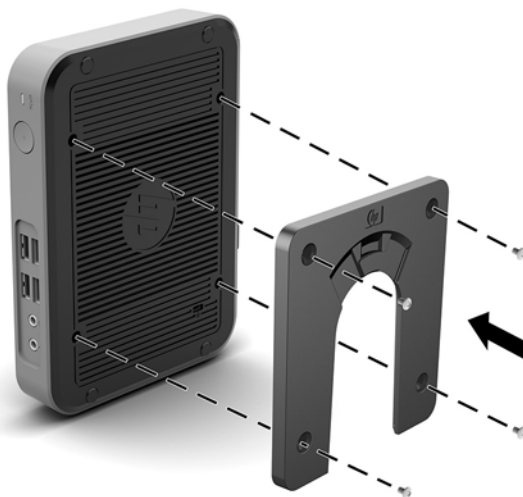
ไคลเอ็นต์แบบบางเครื่องนี้ประกอบด้วยจุดยึดสี่จุดที่บริเวณด้านขวาของตัวเครื่อง จุดยึดเหล่านี้เป็นไปตามมาตรฐาน VESA (Video Electronics Standards Association) ซึ่งเป็นผู้กำหนดรูปแบบการยึดติดตั้งมาตรฐานในระดับอุตสาหกรรมสำหรับจอแสดงผลแบบแบน (FD) เช่น จอภาพแบบแบน จอแสดงผลแบบแบน และโทรทัศน์จอแบน HP Quick Release เชื่อมต่อกับจุดยึดตามมาตรฐาน VESA ช่วยให้คุณสามารถติดตั้งเครื่องไคลเอ็นต์แบบบางได้หลากหลายรูปแบบ

 **หมายเหตุ:** โปรดใช้สกรูขนาด 10 มม. ที่ให้มาพร้อมกับ HP Quick Release ในการยึดติดไคลเอ็นต์แบบบาง

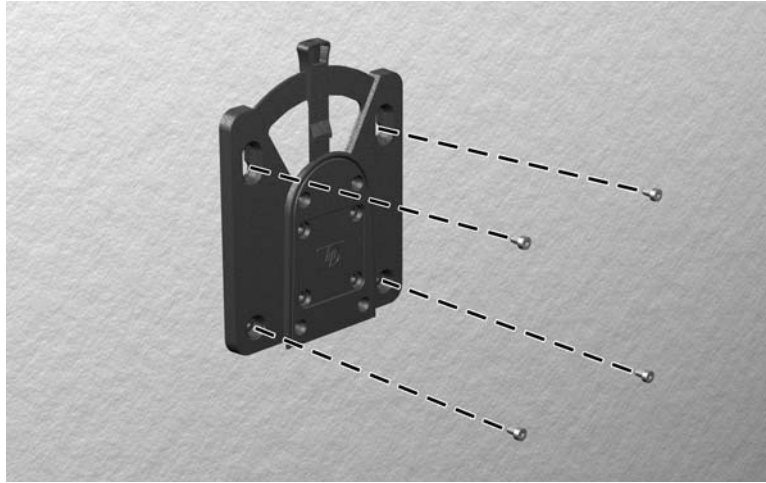


การใช้ HP Quick Release:

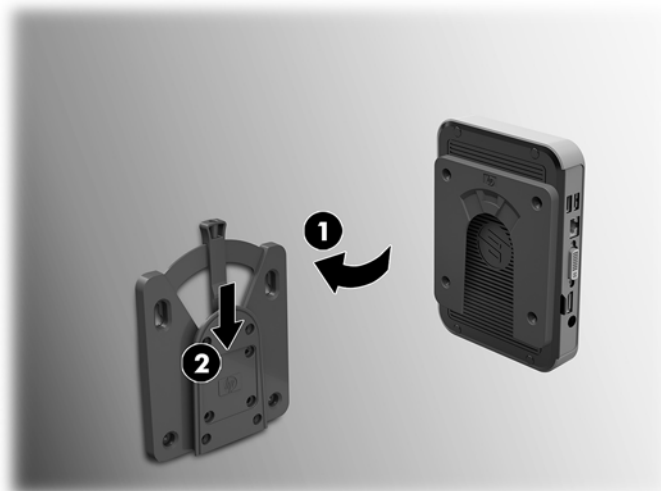
1. ใช้สกรู 10 มม. ทั้งสี่ตัวที่ให้มาพร้อมชุดอุปกรณ์สำหรับการติดตั้ง โดยให้ติดตั้งด้านหนึ่งของ HP Quick Release เข้ากับไคลเอ็นต์แบบบางตามที่แสดงในภาพประกอบต่อไปนี้



2. ใช้สกรูสี่ตัวที่ให้มาพร้อมชุดอุปกรณ์สำหรับการติดตั้ง โดยให้ติดอีกด้านหนึ่งของ HP Quick Release เข้ากับอุปกรณ์ที่คุณจะยึดติดกับไคลเอ็นต์แบบบาง ตรวจสอบให้แกนปลดล็อกหงายขึ้น



3. เลื่อนด้านข้างของอุปกรณ์ยึดติดซึ่งยึดกับไคลเอ็นต์แบบบาง (1) เข้ากับอีกด้านของอุปกรณ์ยึดติด (2) บนอุปกรณ์ที่คุณต้องการยึดติดกับไคลเอ็นต์แบบบาง หากมีเสียง 'คลิก' ดังขึ้น แสดงว่าการเชื่อมต่อเป็นไปอย่างเรียบร้อย



**⚠️ ข้อควรระวัง:** เพื่อให้การทำงานของ HP Quick Release เป็นไปอย่างถูกต้องและเพื่อการติดตั้งส่วนประกอบทั้งหมดอย่างแน่นหนา โปรดตรวจสอบว่าแกนปลดล็อกอยู่ในด้านที่ติดกับตัวเครื่อง และส่วนโค้งมนของฉลากยึดซึ่งติดอยู่กับพื้นผิวหรือวัตถุอีกฝั่งหนึ่ง ทั้งสองส่วนนั้นอยู่ในลักษณะตั้งขึ้น

**📝 หมายเหตุ:** เมื่อยึดติดเรียบร้อยแล้ว HP Quick Release จะล็อกเข้าตำแหน่งโดยอัตโนมัติ และเมื่อต้องการถอดไคลเอ็นต์แบบบางออก ให้เลื่อนแกนไปยังอีกด้านหนึ่ง

## รูปแบบการติดตั้งที่รองรับ

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงถึงรูปแบบการติดตั้งที่รองรับบางลักษณะสำหรับฉากยึดการติดตั้ง

- ติดกับด้านหลังของจอภาพ:



- ติดบนผนัง:



- ติดได้โต๊ะทำงาน:



## รูปแบบและลักษณะการติดตั้งที่รองรับ

**⚠ ข้อควรระวัง:** คุณต้องจัดวางตัวเครื่องให้อยู่ในลักษณะที่ HP กำหนดเพื่อให้ไคลเอ็นต์แบบบางของคุณทำงานได้ตามเหมาะสม ไคลเอ็นต์แบบบางต้องใช้งานร่วมกับแท่นวางเพื่อให้เกิดการถ่ายเทอากาศโดยรอบตัวเครื่องอย่างเหมาะสม ยกเว้นเฉพาะในกรณีที่มีการติดตั้งไคลเอ็นต์แบบบางเข้ากับ HP Quick Release

- HP รองรับการจัดวางไคลเอ็นต์แบบบางตามแนวนอน:



- HP รองรับการใช้ไคลเอ็นต์แบบบางในลักษณะวางตั้งด้วยการติดตั้งแท่นวาง:



- ไคลเอ็นต์แบบบางอาจถูกจัดวางเอาไว้ใต้แท่นวางจอภาพได้โดยต้องมีพื้นที่ว่างอย่างน้อย 2.54 ซม. (1 นิ้ว):





## รูปแบบการจัดวางที่ไม่รองรับ

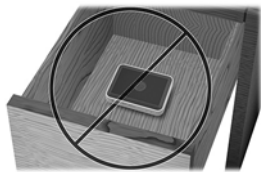
HP ไม่รองรับการจัดวางไคลเอ็นต์แบบบางในลักษณะต่างๆ ดังต่อไปนี้:

**⚠ ข้อควรระวัง:** การจัดวางไคลเอ็นต์แบบบางในลักษณะที่ไม่รองรับอาจทำให้เกิดการทำงานผิดพลาด และ/หรือเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ได้

ไคลเอ็นต์แบบบางต้องจัดวางเอาไว้ในที่ที่มีการระบายอากาศได้ดีเพื่อให้มีอุณหภูมิเหมาะสมในการทำงาน อย่าให้มีสิ่งใดขวางทางระบายอากาศ

อย่าวางไคลเอ็นต์แบบบางในลิ้นชักหรือในพื้นที่ปิดทึบ อย่าวางจอภาพหรือวัตถุอื่นใดบนเครื่องไคลเอ็นต์แบบบาง ห้ามติดตั้งไคลเอ็นต์แบบบางระหว่างผนังและจอภาพ เพราะตัวเครื่องต้องจัดวางเอาไว้ในที่ที่มีการระบายอากาศได้ดีเพื่อให้มีอุณหภูมิเหมาะสมในการทำงาน

- ในลิ้นชักโต๊ะทำงาน:



- วางจอภาพไว้ด้านบนตัวเครื่องไคลเอ็นต์แบบบาง:



## การดูแลรักษาตามปกติสำหรับไคลเอ็นต์แบบบาง

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้เพื่อดูแลรักษาไคลเอ็นต์แบบบางของคุณอย่างเหมาะสม:

- อย่าใช้งานไคลเอ็นต์แบบบางระหว่างที่ถอดแผงภายนอกออก
- อย่าวางไคลเอ็นต์แบบบางไว้ในบริเวณที่มีความชื้นสูง สัมผัสแสงแดดโดยตรง และมีอุณหภูมิที่ร้อนจัดหรือเย็นจัด สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิและช่วงระดับความชื้นที่แนะนำสำหรับไคลเอ็นต์แบบบาง โปรดดูได้จาก <http://www.hp.com/go/quickspecs>
- อย่าวางของเหลวไว้ใกล้กับเครื่องไคลเอ็นต์แบบบางและเป็นพิมพ์
- ปิดเครื่องไคลเอ็นต์แบบบาง แล้วเช็ดพื้นผิวภายนอกด้วยผ้านุ่มที่ชุบน้ำหมาดๆ ตามที่จำเป็น การใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดอาจทำให้สื่อบันทึกข้อมูลเสียหายหรือทำลายสื่อบันทึกข้อมูล

## 3 การคายประจุไฟฟ้าสถิต

ประจุไฟฟ้าสถิตจากนิ้วมือหรือสื่อนำไฟฟ้าต่างๆ อาจทำความเสียหายให้กับเมนบอร์ดหรือชิ้นส่วนอื่นๆ ที่ไวต่อไฟฟ้าสถิต ความเสียหายประเภทนี้อาจลดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ลง

### การป้องกันความเสียหายจากการคายประจุไฟฟ้าสถิต

เพื่อป้องกันความเสียหายจากประจุไฟฟ้าสถิต ให้ปฏิบัติตามข้อควรระวังดังต่อไปนี้:

- หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัส ขนย้ายและเก็บผลิตภัณฑ์ในที่เก็บที่ป้องกันไฟฟ้าสถิต
- เก็บชิ้นส่วนที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในหีบห่อของชิ้นส่วนเหล่านั้น จนกว่าชิ้นส่วนเหล่านั้นจะอยู่ในเนื้อที่ทำงานที่ไม่มีไฟฟ้าสถิต
- วางชิ้นส่วนบนพื้นผิวที่มีการลงกราวด์ก่อนที่จะนำออกจากภาชนะที่เก็บ
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสขา ชั่ว หรือวงจรถองอุปกรณ์
- มีการลงกราวด์อย่างเหมาะสมทุกครั้ง เมื่อสัมผัสอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนที่ไวต่อไฟฟ้าสถิต

### วิธีการต่อสายดิน

วิธีการลงกราวด์นั้นมีหลายวิธี โปรดใช้วิธีการหนึ่งใดดังต่อไปนี้เพื่อจัดการหรือติดตั้งชิ้นส่วนที่ไวต่อไฟฟ้าสถิต:

- ใช้สายรัดข้อมือที่เชื่อมต่อสายกราวด์เพื่อการกราวด์ตัวเครื่องไคลเอ็นต์แบบบาง สายรัดข้อมือดังกล่าวเป็นสายรัดที่ยืดหยุ่นได้ ซึ่งมีแรงต้าน 1 megohm +/- 10 เปอร์เซ็นต์ ในสายกราวด์ ทั้งนี้เพื่อการลงกราวด์ที่เหมาะสม ควรสวมสายรัดให้แนบกับผิวหนัง
- ใช้สายรัดข้อเท้า นิ้วเท้า หรือรองเท้าในพื้นที่ทำงานแบบยืน สวมสายรัดข้อเท้าทั้งสองข้างเมื่อยืนบนเนื้อที่นำไฟฟ้าหรือแผ่นรองเนื้อที่มีการกระจายกระแสไฟฟ้า
- ใช้เครื่องมือสนามที่มีการนำไฟฟ้า
- ใช้ชุดซ่อมบำรุงแบบพกพาพร้อมแผ่นรองเนื้อที่มีการกระจายกระแสไฟฟ้าแบบพับได้

หากไม่มีอุปกรณ์ที่แนะนำข้างต้นในการเดินสายดิน โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย ผู้ขายปลีก หรือศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของ HP




**หมายเหตุ:** สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย ผู้จำหน่าย หรือผู้ให้บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก HP

## 4 ข้อมูลการขนย้าย

### การเตรียมการขนย้าย

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ในการเตรียมการขนย้ายเครื่องไคลเอ็นต์แบบบาง:

1. ปิดเครื่องไคลเอ็นต์แบบบางและอุปกรณ์ภายนอก
2. ถอดสายไฟ AC ออกจากเต้าเสียบ AC แล้วจึงถอดออกจากตัวเครื่องไคลเอ็นต์แบบบาง
3. ถอดส่วนประกอบของเครื่องและอุปกรณ์ภายนอกออกจากแหล่งจ่ายไฟ จากนั้นถอดออกจากเครื่องไคลเอ็นต์แบบบาง
4. บรรจุส่วนประกอบของระบบและอุปกรณ์ภายนอกไว้ในหีบห่อเดิมของอุปกรณ์เหล่านั้นหรือหีบห่อที่คล้ายกัน โดยมีวัสดุกันการกระแทก

 **หมายเหตุ:** สำหรับช่วงค่าทางสภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถทำงานได้ โปรดดูได้ที่ <http://www.hp.com/go/quickspecs>

### ข้อมูลบริการซ่อมแซมที่สำคัญ

กรุณาถอดและปกป้องอุปกรณ์เสริมภายนอกทั้งหมดก่อนส่งคืนเครื่องไคลเอ็นต์แบบบางกลับมายัง HP เพื่อการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทดแทนในทุกกรณี

สำหรับในประเทศที่มีบริการให้ลูกค้าสามารถส่งสินค้าซ่อมแซมผ่านไปรษณีย์ HP จะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อจัดส่งสินค้าที่ซ่อมแซมแล้วให้แก่ลูกค้า โดยใช้หน่วยความจำภายในและโมดูลเฟลชชุดเดิม


สำหรับในประเทศที่ไม่มีบริการให้ลูกค้าสามารถส่งสินค้าซ่อมแซมผ่านไปรษณีย์ได้ คุณต้องถอดอุปกรณ์เสริมภายในทุกชิ้นและปกป้องให้เรียบร้อยนอกเหนือไปจากอุปกรณ์เสริมภายนอกต่างๆ ทั้งนี้ควรเรียกคืน**ค่าดั้งเดิม**ของระบบก่อนที่จะจัดส่งกลับมายัง HP เพื่อการซ่อมแซม

## 5 คุณสมบัติสำหรับผู้ทุพพลภาพ

HP ได้ออกแบบ ผลิต ตลอดจนทำตลาดผลิตภัณฑ์และบริการซึ่งทุกคนรวมทั้งผู้พิการสามารถใช้ ได้ไม่ว่าจะเป็นแบบสแตนด์อะโลน หรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่มีความเหมาะสม

### เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกที่รองรับ

ผลิตภัณฑ์ของ HP สนับสนุนเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกบนระบบปฏิบัติการที่มีความหลากหลาย และคุณสามารถกำหนดค่าให้ใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมได้ ใช้คุณสมบัติการค้นหาซึ่งอยู่บนอุปกรณ์ของคุณเพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของสิ่งอำนวยความสะดวก

 **หมายเหตุ:** สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เฉพาะที่มีเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าสำหรับสินค้าอื่นๆ

### การติดต่อฝ่ายสนับสนุน

เราได้ทำการปรับแต่งระบบการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการอย่างสม่ำเสมอ และยินดีรับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือต้องการแจ้งเกี่ยวกับ คุณลักษณะด้านความสะดวกในการใช้งานที่เป็นประโยชน์แก่คุณ โปรดติดต่อเราที่ (888) 259-5707 วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 6:00-21:00 ตามเวลาเมาน์เทนไทม์ในสหรัฐฯ หากคุณทุพพลภาพทางการได้ยินและใช้ TRS/VRS/WebCapTel โปรดติดต่อเราหากคุณต้องการขอความช่วยเหลือทางเทคนิค หรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยในการเข้าถึง โดยให้ติดต่อมาที่ (877) 656-7058 วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 6:00-21:00 ตามเวลาเมาน์เทนไทม์ในสหรัฐฯ

# ดัชนี

## H

HP Quick Release 6

## Q

Quick Release 6

## ก

การคายประจุไฟฟ้าสถิต 12

การดูแลรักษาตามปกติ 11

การติดตั้ง

HP Quick Release 6

สายล๊อค 5

ไคลเอ็นต์แบบบางเข้ากับ HP Quick

Release 6

การต่อสายไฟ AC 4

การถอด

แฟลชไดรฟ์ USB 13

โมดูลจัดเก็บข้อมูล M.2 13

การป้องกันความเสียหายจากการคาย

ประจุไฟฟ้าสถิต 12

การเตรียมการขนย้าย 13

## ข

ข้อควรระวัง

HP Quick Release 7

การติดตั้งแหวนวาง 3

การระบายอากาศ 11

การเกี่ยวยึดสายไฟ 4

รูปแบบการจัดวางไคลเอ็นต์แบบบาง

11

ลักษณะการจัดวางของไคลเอ็นต์

แบบบาง 10

ไฟฟ้าช็อต 3

ไฟฟ้าสถิต 3

## ค

คำเตือน

การไหม้ 3

ปลั๊กสำหรับการต่อสายดิน 3

ภาครับของอินเตอร์เฟซระบบเครือข่าย

ข่าย 3

ไฟฟ้าช็อต 3

คำแนะนำในการติดตั้ง 3

คุณสมบัติสำหรับผู้หุพผลภาพ 14

## ด

ตัวเลือกสำหรับการติดตั้ง

ติดกับด้านหลังของแหวนวางจอภาพ 8

ติดบนผนัง 8

ติดใต้โต๊ะทำงาน 8

ตำแหน่งของหมายเลขผลิตภัณฑ์ 2

## ท

เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกที่รองรับ

14

แหวนวาง, การประกอบ 3

แหวนวางสำหรับตัวเครื่องแบบทาวเวอร์ 3

## บ

บริการซ่อมแซม 13

## ผ

ฝ่ายสนับสนุน, การติดต่อ 14

## ฟ

แฟลชไดรฟ์ USB, การถอดเปลี่ยน 13

## ม

โมดูลจัดเก็บข้อมูล M.2, การถอด 13

## ร

รูปแบบการจัดวางที่รองรับ

ใต้แหวนวางจอภาพ 10

รูปแบบการจัดวางที่ไม่รองรับ

วางไว้ใต้จอภาพ 11

ในลิ้นชัก 11

รูปแบบการติดตั้งที่รองรับ 8

## ล

ลักษณะการจัดวาง, แนวนอน 10

ลักษณะการจัดวางที่รองรับ

แนวนอน 10

## ว

วิธีการต่อสายดิน 12

เว็บไซต์

HP 1

## ส

สายล๊อค, การติดตั้ง 5

ส่วนประกอบ

แผงด้านหน้า 1

แผงด้านหลัง 2

ส่วนประกอบที่แผงด้านหน้า 1

ส่วนประกอบที่แผงด้านหลัง 2

## อ

อุปกรณ์เสริม 1, 5